

流程圖

負責人	作業流程	使用表格
化金課	<pre> graph TD subgraph Column1 [] direction TB C1_1[上料] --> C1_2[交換位] C1_2 --> C1_3[脫脂] C1_3 --> C1_4[熱水洗] C1_4 --> C1_5[水洗] C1_5 --> C1_6[水洗] C1_6 --> C1_7[微蝕] C1_7 --> C1_8[水洗] C1_8 --> C1_9[水洗] C1_9 --> C1_10[酸洗] end subgraph Column2 [] direction BT C2_1[化鎳] --> C2_2[純水洗] C2_2 --> C2_3[純水洗] C2_3 --> C2_4[純水洗] C2_4 --> C2_5[空槽] C2_5 --> C2_6[後浸] C2_6 --> C2_7[活化] C2_7 --> C2_8[預浸] C2_8 --> C2_9[純水洗] C2_9 --> C2_10[純水洗] end subgraph Column3 [] direction TB C3_1[純水洗] --> C3_2[純水洗] C3_2 --> C3_3[熱純水洗] C3_3 --> C3_4[化金] C3_4 --> C3_5[回收] C3_5 --> C3_6[純水洗] C3_6 --> C3_7[熱純水洗] C3_7 --> C3_8[下掛] end C1_10 --> C2_10 C2_1 --> C3_1 </pre>	<p>點檢表 一級保養記錄表 8-1 化金線首件 檢查記錄表。 8-2 化金線鎳、 金藥水槽 PH 檢測表。 8-3 化金線藥液 更槽記錄表。 8-4 化金線水洗 槽更槽記錄 表。</p>

6-3 操作條件

名稱	藥液名稱	濃度範圍	溫度	分析頻率	更槽頻率
酸性清潔槽	H ₂ SO ₄	-	40°C (35-45)	每天一次	14 天
微蝕槽	SPS	-	28°C (25-40)	每天一次	Cu > 12 g/L
	H ₂ SO ₄	-			
	Cu 含量	-			
酸洗槽	H ₂ SO ₄	-	RT	每天一次	2 天
預浸槽	H ₂ SO ₄	-	RT	每天一次	3 天
活化槽	Pd	-	23°C (20-27)	每班一次	Cu > 100 ppm 或一個月
	H ₂ SO ₄	-			
後浸槽	H ₂ SO ₄	-	RT	每天一次	2 天
化學鍍槽	Ni	-	83°C (80-90)	每班一次	6MTO 或 防析出電流>0.8Amp
	NaH ₂ PO ₂	-		每天一次	
	pH	-		每班一次	
	NaH ₂ PO ₃	-		每天一次	
浸金槽	Au	-	86°C (80-90)	每班一次	8MTO 或 Ni > 800ppm 或 Cu > 5ppm
	Cu 含量	-		每天一次	
	鍍含量	-		每天一次	
	PH	-		每班一次	
★金、鍍厚度檢查	首件檢查分每批、每班、新料號，製作中檢查為每 2 小時進行			拿 2 片板子、每面 5 點、共 20 點 以 X-RAY 測金、鍍厚度	